

“熱”のお悩み、解決します ～IDAJ総合熱設計支援サービス～

電子機器の熱設計は、電気業界のみならず自動車や重工業界でも重要な設計課題としてプライオリティが高くなっています。また、電子機器の小型化と高性能化により、もはや製品の熱問題は、設計の初期から検討を始めるなければならない状況に直面しています。

IDAJでは、このような熱問題に対するソリューションとして、Simcenter Flothermをはじめとする解析ツールのご提供だけでなく、様々なサービスメニューをご提案しています。総合熱設計支援として、熱設計と熱流体解析のエキスパートエンジニアが、お客様の課題解決を支援します。

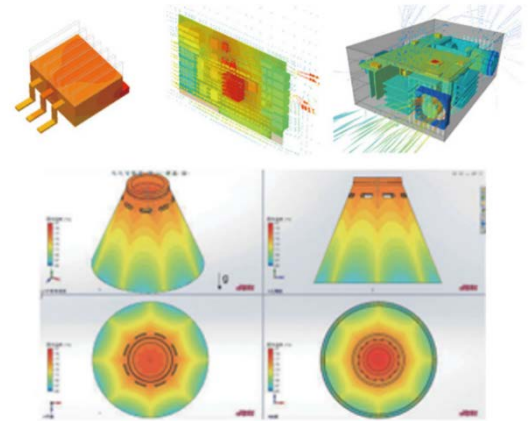


Simcenter Flotherm・Simcenter Flotherm XTを用いた委託解析

すぐに、熱シミュレーションの結果が欲しい

- ・製品に熱問題が発生中、すぐに複数の熱対策方法とその効果を検証し、どの方法を採用するか決定しなければならない
- ・熱解析は実施したいが、熱設計担当エンジニアが多忙で時間がとれない
- ・Simcenter Flothermなどの熱流体解析ツールの実力を知りたい

など

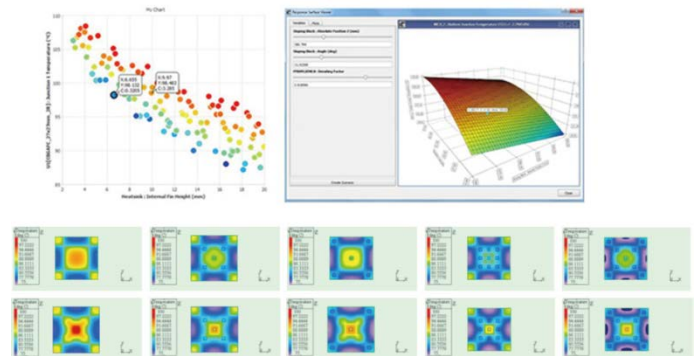


さまざまな熱シミュレーションの結果

筐体の放熱対策をパラメトリックに評価したい

- ・メカ設計者がおこなった、筐体の放熱対策や冷却装置設計を検証したい
- ・インバータモジュールの水冷ピンフィンヒートシンクの形状を最適化したい

など

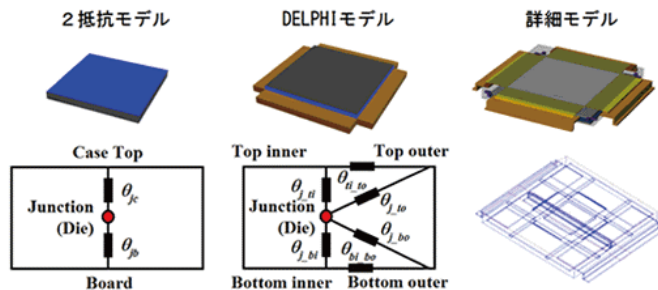


ICパッケージ内蔵スタンドオフの検討

半導体パッケージ部品の熱解析用モデルが欲しい

- ・ 自社開発の半導体パッケージの熱抵抗 (θ_{jc} , θ_{jb} , Ψ_{jt} など) を求めたい
- ・ モデル作成時にノウハウが必要なSiPやCSPなどのモデルを作成してお客様に提供したい
- ・ T3STERによる熱特性実測結果と比較するための熱解析モデルが欲しい

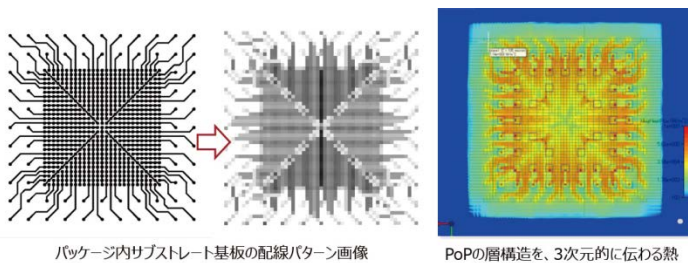
など



半導体パッケージモデル

基板の放熱特性を確認したい

- ・ 基板の配線パターンや各種熱対策による放熱効果をお客様に提案したい
- ・ 配線層のレイアウトを変えることによる放熱パスの変化を見たい
- ・ 基板のビアの配置や数を検討したい



パッケージ内サブストレート基板の配線パターン画像

PoPの層構造を、3次元的に伝わる熱

部品内蔵基板 (Package on Package) の熱解析



熱設計コンサルティングサービス

熱設計エンジニアの早期育成 社内で熱設計のルールやプロセスを構築 製品に対して放熱対策のアドバイス

技術顧問の国峯 尚樹をはじめ、経験豊富な熱設計エンジニアによる、熱設計コンサルティングの実施が可能です。

どのように熱設計を始めればよいのかわからない、メカ設計者と回路設計者の間での熱設計のルール構築をサポートしてほしい、熱設計のスペシャリストを養成するトレーニングメニューを作りたいなど、内容にあわせてオーダーメイドでコンサルティングメニューをご提案します。